

平成17年3月期中間期決算関連Q&A概要

【計測器事業に関するQ&A】

Q1: 国内の第3世代移動通信（3G）関連計測器について

A1: 当初は、通信制御の開発用テストは減少傾向を想定していたが、中間期実績はそれを大幅に上回る結果となった。今後は3.5世代（HSDPA）対応へのアップグレードもビジネスが見込める。また、新製品のアプリケーション開発用テストも予定どおり売上が伸びており、3G関連でのビジネスは当面期待できるとみている。

Q2: 海外の移動通信関連計測器について

A2: 海外の移動通信関連市場は、今後、第2世代から第3世代へ規格の移行が進むことが予想され、当社としてはここに商機があると考えている。近年は、第2世代の規格だけでなく、W-CDMAやCDMA2000などの第3世代規格への対応力が求められているが、当社はW-CDMA規格について圧倒的な技術的優位性を有するとともに、GSMなどの第2世代を含むマルチシステム対応にも以前から取り組んでおり、今後は互角の戦いができると考えている。日本以外の市場に限定すると競合と比較してやや出遅れている感があるが、今後はマルチシステム対応やサポート対応力をより一層強化することにより、海外市場を拡大していく。

Q3: 製造用の移動通信向け計測器について

A3: 日本国内は想定どおりの実績だったが、海外では、特に中国が3Gライセンス発給の遅れの影響もあり未達となった。下半期で中国市場での挽回を計画しているが、地域別の通期見通しではアジア向け売上を10億円下方に修正した。全体としては好調な日本市場もあり年度見通しを変えていない。中国の3Gサービス開始は2006年には始まると考えており、中期経営計画の達成への影響はないと考えている。

Q4: ICチップ開発用計測器への取り組みについて

A4: 主力は通信制御の開発用のシグナリングテストであり、端末開発用計測器と製品自体に差はない。しかし、開発されたチップが端末で使用されるというサプライチェーンを考えると、チップの開発段階から当社製品が食い込んでいくことには大きな意味がある。既に、有力メーカーと共同で、新しいチップセットのプロトタイプ試験装置の開発等を進めている。

Q5: 米国において固定通信用の設備投資回復の影響は？

A5: 近年、通信キャリアは、従来の音声通信から画像配信やインターネット接続などへ業容を拡大し、マルチサービスオペレーターとなっている。現在はまだ当社における具体的なビジネス展開が見える状態ではないが、光ファイバ用テストやIPテスト、ピュアフロー（帯域制限装置）などに商機が考えられる。米国内の営業組織の変革などを進め、機が熟すのを待ちたい。
なお、光デバイスメーカーの増産に関連して、高速のBERTSに動きが出てきている。

Q6: ソフトバンクのGE-PON（Gigabit Ethernet-Passive Optical Network）の採用によるビジネス機会は？

A6: 技術的にはさほど目新しいものではないが、今後光ファイバーの敷設が各家庭まで進むことになれば、簡単な操作でファイバーの障害点を計測できる「アクセスマスタ」の需要が期待できる。

【財務に関するQ&A】

Q7: 中間期で利益が上振れた主な要因は？

A7: 粗利益率が前年同期比で約5%改善したことによる。3G関連測定器や、8月販売開始のアプリケーションソフト開発用テストなど、ソフト比率が高く高付加価値の製品が好調だったことによる。今後も利益水準を勘案しながら、設備投資を行い、継続的な利益ある成長を実現していきたい。

Q8: 棚卸資産について、期末の見通しと、今後の圧縮策は？

A8: 2005/3末の状況は、現水準と同程度とみている。今後の改善施策についてだが、現在の棚卸資産については、受注・売上案件のなかで積極的に活用して減らしていきたい。今後の購入部品については、今期から稼働を始めた情報システムを活用し、SCM全体を改善していくことにより棚卸資産の低減を図りたい。なお、現在のリードタイムを平均すると1ヵ月から2ヶ月程度である。また、今年度の棚卸資産評価損は、現在の見通しとしては15億円程度とみている。

以上